

院 所 別	智慧機電學院 機械工程系博士班
招生分組	不分組
身分別	一般生
招生名額	6
研究領域	<p>1.設計與製造：精密機械設計、機構設計、最佳化設計、電腦輔助設計與工程分析、衝擊與破壞力學、生物力學、機器人、智權管理、機械視覺、虛擬實境、微系統設計與製造、智慧製造、精密製造與量測、3D 列印、精微加工、微細加工、塑性加工、雷射加工、網際網路於遠距加工之應用、CAD/CAM、太陽能電池與光電感測元件、微機電系統技術等領域。</p> <p>2.光電與控制：機光電整合、工業 4.0、自動化技術、控制理論、電機機械、馬達設計、超音波馬達、壓電材料應用、光學系統設計量測、投影機顯示技術、微機電系統、微感測器、磁感測、電磁分析、永磁磁石製作、非破壞檢測等領域。</p> <p>3.材料與能源：微奈米製程與檢測技術、材料工程應用、電子材料、射出成形、微成形、機械熱流、微流體、能源科技（太陽能、燃料電池）、場發射元件、電子散熱、高分子加工、非傳統加工等領域。</p>
甄試項目	內容
書面資料審查 (50%)	<p>1.大學部及碩士班歷年成績單正本各一份（應屆畢業生可免繳最後一學期成績單）。</p> <p>2.攻讀博士學位計畫書一份。</p> <p>3.碩士論文一份。  (1)應屆畢業生經指導教授簽證後，得以碩士論文初稿替代。  (2)以同等學力報考或無碩士論文者，請繳交相當碩士論文之著作。</p> <p>4.線上推薦函二封。</p> <p>5.其他有助審查之相關資料各一份【例如：著作、發明（圖說）、工作經驗、研究所能力考試證明等】。</p>
面 試 (50%)	<p>1.訂於 113 年 5 月 4 日（六）辦理面試，另行公告時程。</p> <p>2.符合報考資格考生均可參加面試。</p>
成績計算	<p>1.總成績＝書面資料審查成績×50%+面試成績×50%</p> <p>2.各項成績採百分制計算至小數第 2 位（第 3 位以下四捨五入）</p>
同分參酌順序	<p>1.面試成績</p> <p>2.書面資料審查成績</p>
備 註	上課地點：建工校區。
聯絡方式	聯絡人：施先生 電話：07-3814526 轉 15319